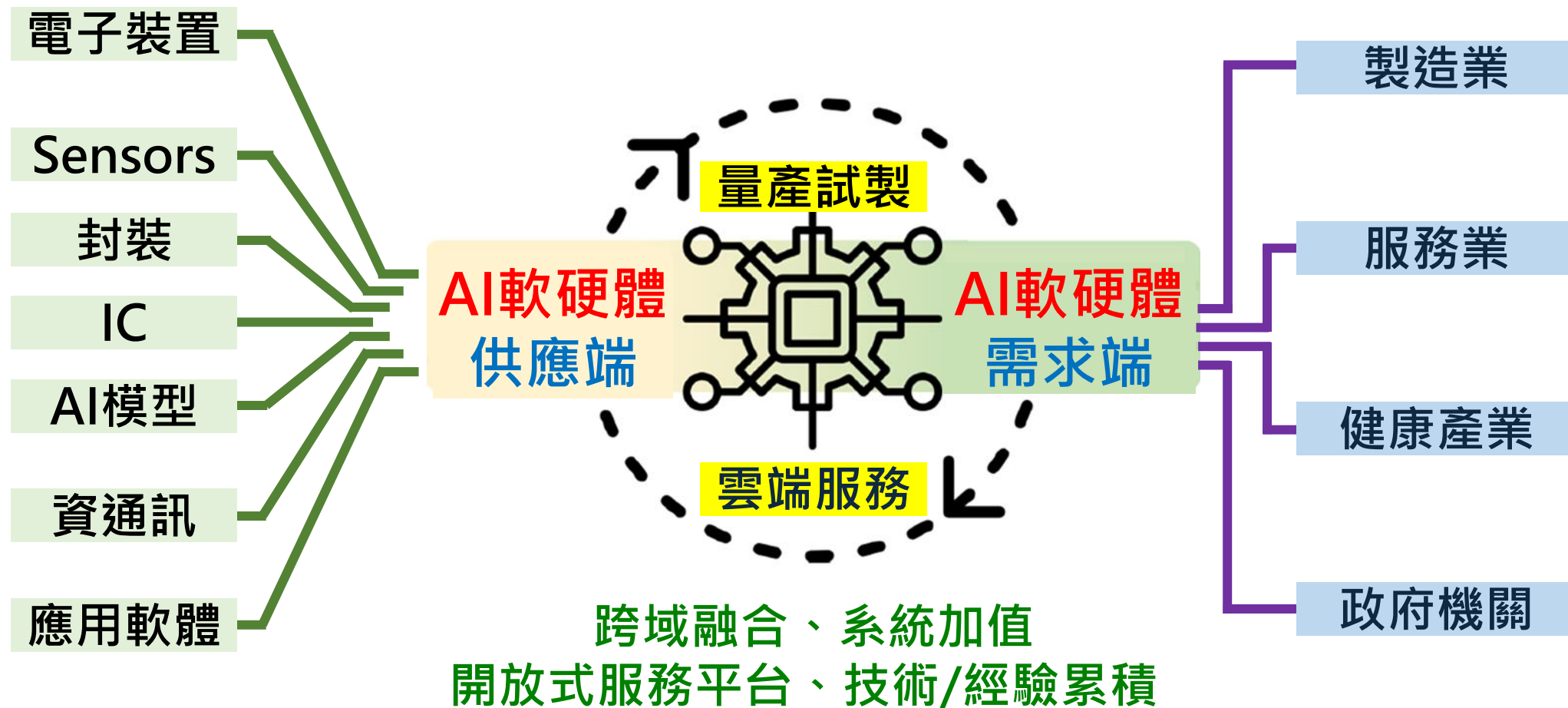


核定日期：2025/4/9

臺灣智慧系統整合製造平台定位

瞭解產業實際需求(特別是系統層級的跨域需求)，提供結合**人工智慧**與**晶片系統專業**的一站式服務及解決方案。



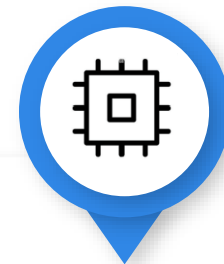
臺灣智慧系統整合製造平台運作機制



需求端

- 企業需求端優先考慮國內中小、新創及跨域系統業者
- 產業屬性為傳產、服務、製造業及其他符合「大南方新矽谷推動方案」推動精神之產業

DEMAND



供應端

- 平台供應端包括業者、學界或法人
- 組成工作小組：架構設計、模型訓練、軟體設計、晶片設計、模組設計、少量試製、系統整合、場域驗證

SUPPLY

臺灣智慧系統整合製造平台運作機制



需求端

DEMAND



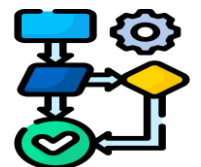
申請
對象

以國內中小、新創及跨域系統業者為主



產業
屬性

傳產、服務、製造業及其他符合「大南方新矽谷推動方案」推動精神之產業



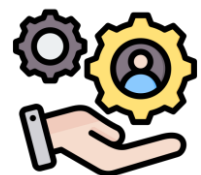
申請
流程

資格審、初審、複審



收費
規範

不需客製化者：免費
需客製化者：部分分攤(個案討論)



服務
流程

通過後組成工作小組，指派個案管理師服務

臺灣智慧系統整合製造平台機制(需求端)



需求端

- 國內中小、新創及跨域系統業者
- 有智慧系統應用需求或有意開發晶片
- 現有供應鏈無法服務

1.資格審

- 書審
繳交指定資料
- 隨到隨審，不超過 5 個工作天
- 評審為推動辦公室人員

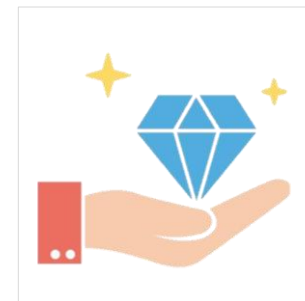
2.初審

- 會議審
實體/視訊出席
- 隨到隨審，可數次
- 技術長擔任主審，邀請專家3~5人，採共識決

3.複審

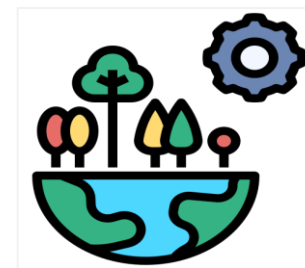
- 會議審
需求業者需實體出席
- 初審結束後一個月內完成
- 技術長邀請產學研專家5~7人，並指定一位擔任主審，採共識決

審查評分項目



價值 創造性

- 第一級：開發新市場之嶄新應用
- 第二級：現有產品的加值應用
- 第三級：降低成本之應用

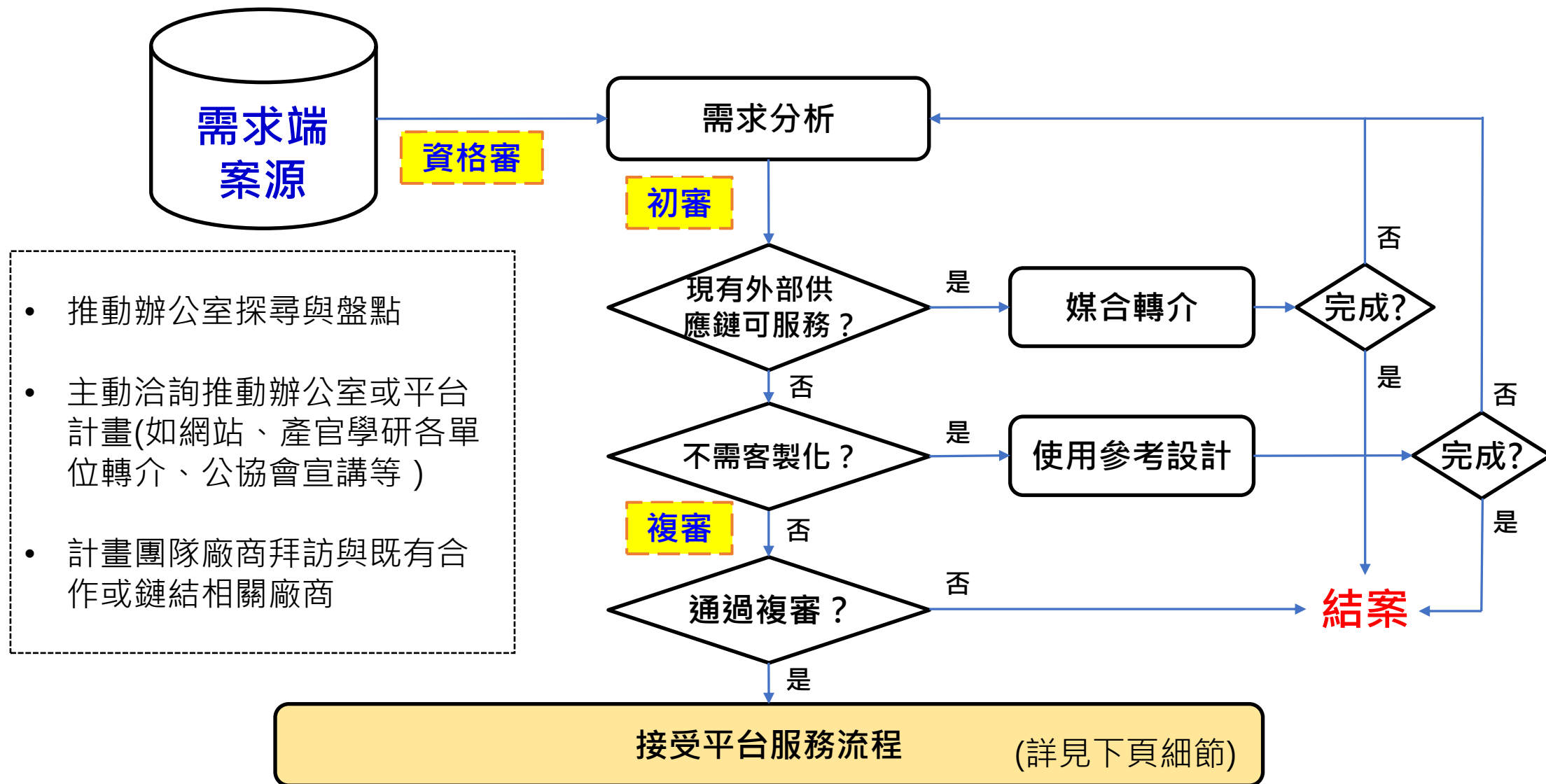


在地 連結性

鏈結產業鏈，包括AI、半導體或電子資通訊領域之上中下游業者，發揮供應鏈整合與加值帶動效用

臺灣智慧系統整合製造平台機制(需求端)

收案與審查流程



臺灣智慧系統整合製造平台機制(需求端)

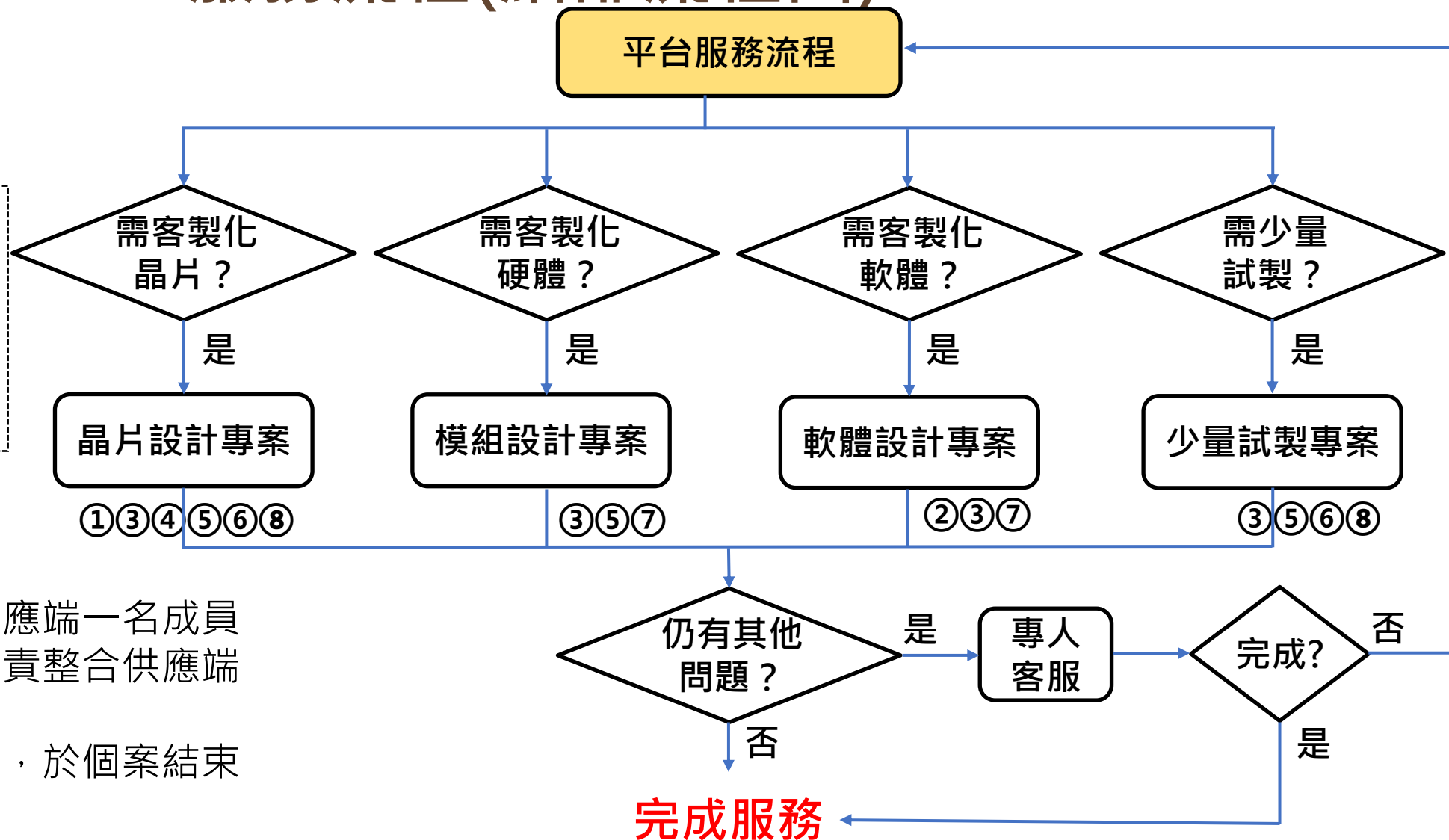
服務流程(細部流程圖)

選擇工作小組

- | | |
|--------|--------|
| ① 架構設計 | ⑤ 模組設計 |
| ② 模型訓練 | ⑥ 少量試製 |
| ③ 軟體設計 | ⑦ 系統整合 |
| ④ 晶片設計 | ⑧ 場域驗證 |

指派個案管理師

- 由評審委員會指派供應端一名成員擔任**個案管理師**，負責整合供應端能量與需求端對接
- 每兩週填報個案進度，於個案結束後持續追蹤效益。



臺灣智慧系統整合製造平台機制(需求端)

收費規範

不需客製化

免費服務

- 需求分析
- 媒合轉介
- 使用參考設計
免開發費

需客製化

分攤部分成本

- 一次性工程費用
- 權利金
- 維護費

◆ 一次性工程費用(NRE)

- 供應商之一次性工程費用(含人力成本、耗材、打樣與試作成本)由供應商與需求端業主協商
- 平台服務團隊之人力成本依(實際工時與費率相乘加總)乘以(評定之分級折扣)，耗材、打樣與試作成本不優惠。分級折扣依價值創造性與在地連結性由複審會議決定(需求端於此項目需分攤之成本不高於50%)

◆ 權利金(Royalty)

- 由需求端業主、平台與各供應端成員依據服務項目、貢獻比重協商

◆ 維護費 (Maintenance Fee)

- 依所需之設備使用費與人力成本實報實收

臺灣智慧系統整合製造平台運作機制



供應端

SUPPLY



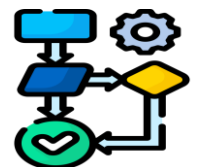
申請
對象

業者、學界或法人



權利
義務

權利：參與活動、供需媒合、納入參考設計方案
義務：資訊保密、配合專案導入提供協助



申請
流程

資格審、複審



I P
共享

既有IP：權利保留於原提供者
共同產出IP：與平台共享，可共同推廣及擴散成果



分潤
機制

一次性工程費用：依據投入比重進行議定
權利金：系統整合者與各協辦者進行議定

臺灣智慧系統整合製造平台機制(供應端)



供應端

1.資格審

- 書審(繳交指定資料)
- 隨到隨審，不超過5個工作天
- 評審為推動辦公室人員

2.複審

- 會議審
- 資格審結束後兩周內完成
- 技術長擔任主審，邀請平台核心成員3~5人，採共識決

成為平台 供應鏈夥伴



權利

- 參與平台舉辦之活動
- 取得供需媒合之機會
- 成為平台參考設計方案

義務

- 對於參與平台運作所得資訊負有**保密義務**，包括客戶相關資訊、專案相關資訊
- 配合專案導入**提供必要協助**，包括提供聯絡窗口、產品與服務項目之規格、交付時程與參考價格、供應鏈合作業者等

臺灣智慧系統整合製造平台機制(供應端)

IP共享機制

IP共享

維持

- 既有IP

共享

- 共同產出之新IP

- 原屬供應端且具完整驗證之IP (Background IP)，不因參與平台專案發生改變
- 供應端學界及業界因參與平台專案而共同產出之新IP (Foreground IP or System IP)，包括特定應用領域之System Know-How、軟硬體參考設計、分析方法及流程工具等，屬平台共享，以利後續推廣及成果擴散。
- 供應端夥伴參與新IP開發時，依提供之IP於專案的重要性、困難度、與成熟度(是否已完整驗證)，經與需求端業主、平台及所有供應商夥伴協商合意後，於複審時提交屬意之一次性工程費用、權利金及維護費計價方式等資訊，通過複審後，參與專案與新IP之研發
- 於專案執行期間合作產出之無形創新智財依專利或商業機密法申請保護，其共享比例依協商合意之貢獻度訂定

臺灣智慧系統整合製造平台機制(供應端)

分潤機制

分潤機制

兩階段 收取

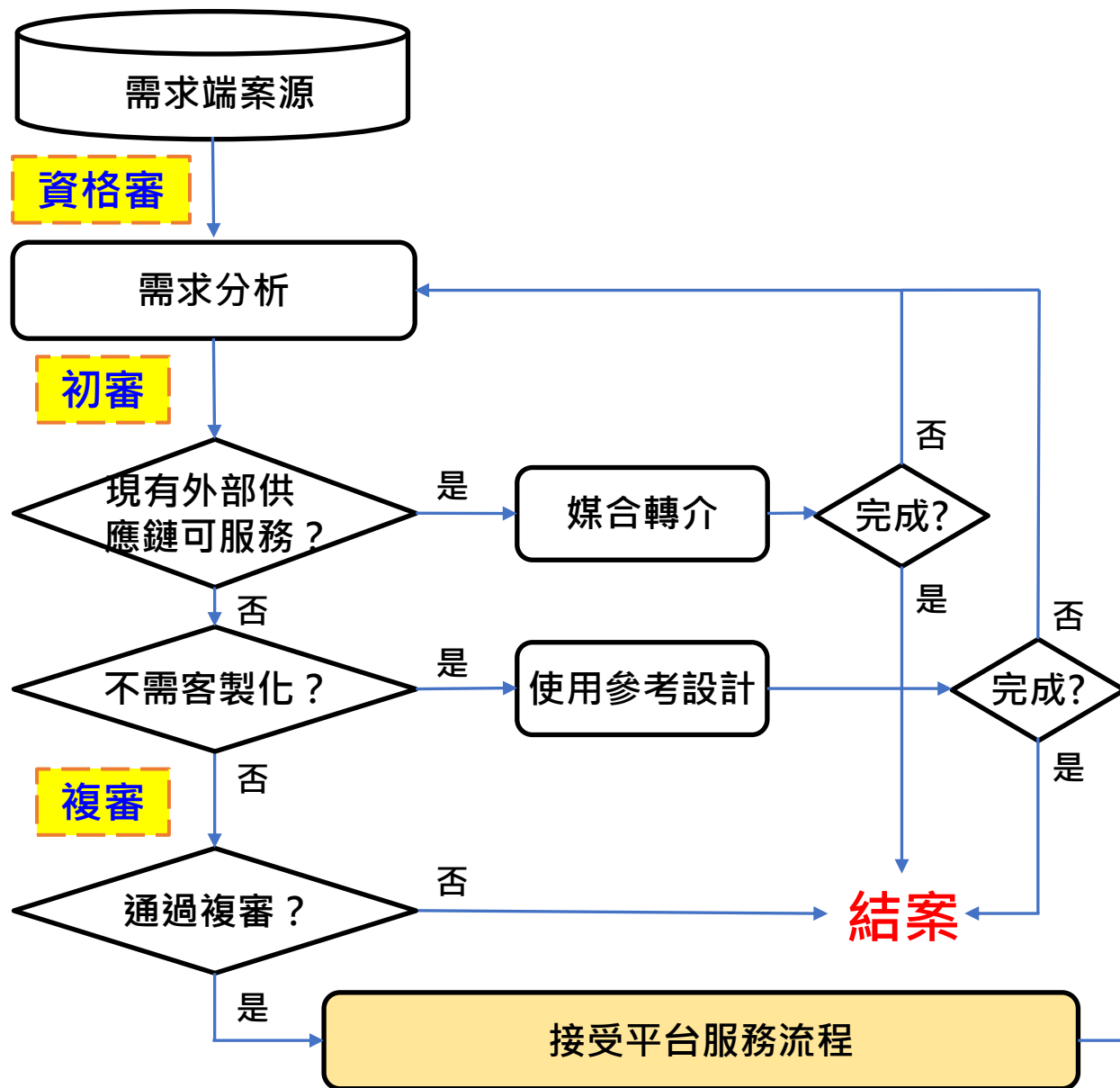
- 系統開發階段
- 量產/銷售階段

供應端成員基於提供之技術與服務項目，得參與分潤，分兩階段收取：

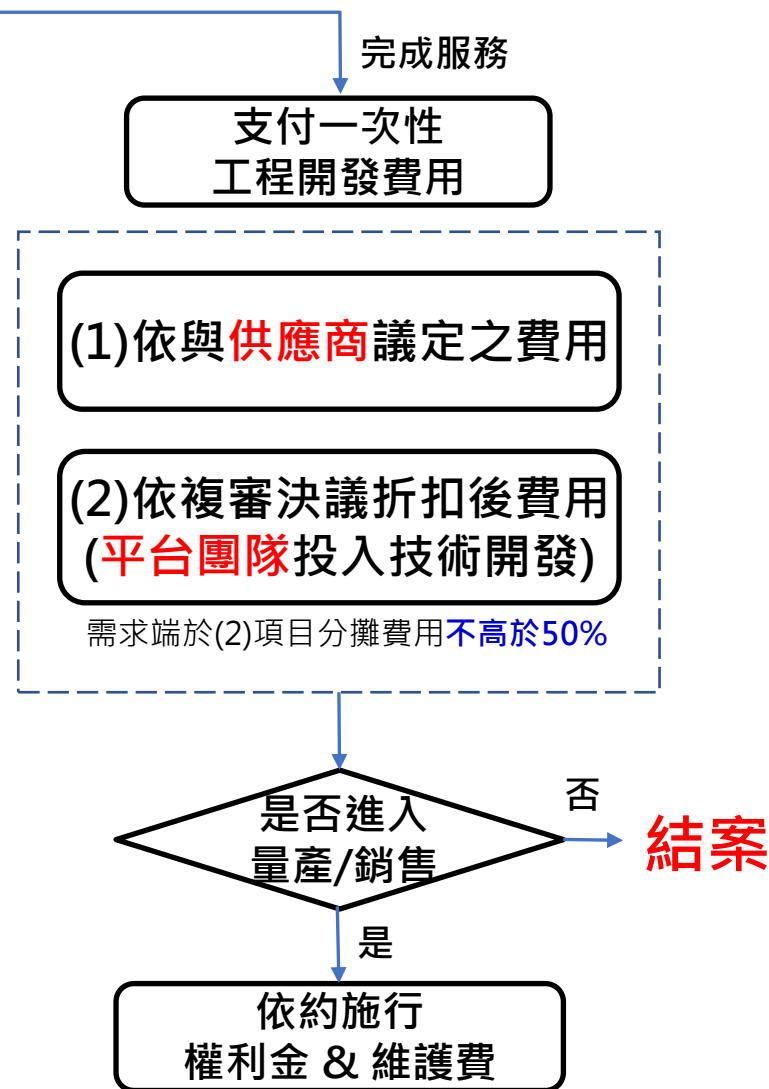
- 1) 一次性工程費用(NRE) 於系統開發階段收取，依據平台與各供應端成員投入比重進行議定。
- 2) 權利金(Royalty)於量產/銷售階段收取，權利金依據平台與各供應端成員貢獻比重進行分配，由系統整合者與各協辦者進行議定。

臺灣智慧系統整合製造平台運作機制整體流程

審查流程



付費流程



臺灣智慧系統整合製造平台運作機制(學界參與)



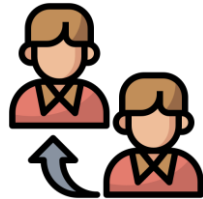
臺灣智慧系統
整合製造平台
Taiwan Smart System Integration
and Manufacturing Platform

學界夥伴可經由
加入需求端或者
加入供應端兩種
方式參與本平台



需求端

DEMAND



協助鏈結及引入AI應
用需求業者



重新評估過往案件：
條件不足或欠缺關鍵整
合能力，由平台協助



供應端

SUPPLY



成為服務平台供應端，
並加入工作小組



將學界已有研發能量
及IP納入平台方案，
或開發新IP

運作機制需填寫文件列表

分類	編號	文件名稱
需求端	A01	需求端調查表
需求端	A02	個人資料蒐集處理及利用之告知暨同意書
需求端	A03	初審簽到表
需求端	A04	初審會議紀錄
需求端	A05	複審簽到表
需求端	A06	複審會議紀錄
需求端	A07	複審_簡報建議格式
需求端	A08	需求端MOU公版
供應端	B01	供應端調查表
供應端	B02	個人資料蒐集處理及利用之告知暨同意書
供應端	B03	複審簽到表
供應端	B04	複審會議紀錄
供應端	B05	供應端MOU公版

	階段	應備文件與填寫單位
需求端	資格審	A01 (廠商) A02 (廠商)
	初審	A03 (推動辦) A04 (推動辦&推動單位)
	複審	A05 (推動辦) A06 (推動辦) A07 (廠商&推動單位) A08 複審通過後簽訂MOU

	階段	應備文件與填寫單位
供應端	資格審	B01 (廠商) B02 (廠商)
	複審	B03 (推動辦) B04 (推動辦) B05 複審通過後簽訂MOU